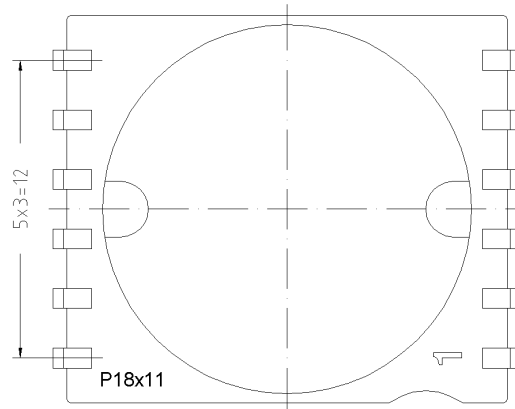
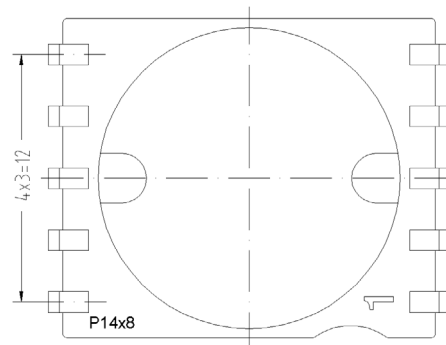
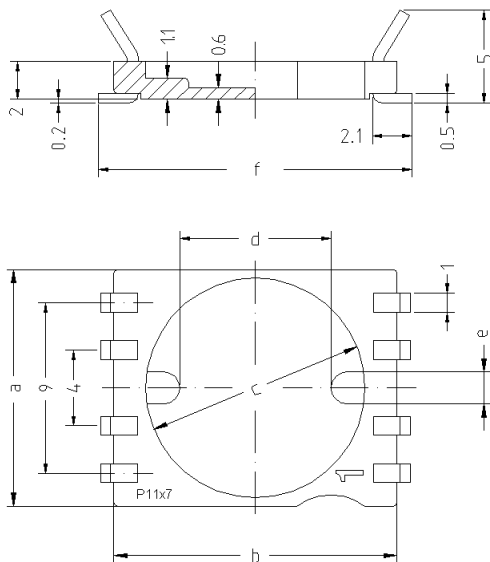




## SMD ANSCHLUSSPLATTE: SMD HEADER



Type	a	b	c	d	e	f
P11Ex7	12,5	15,0	11,6	8,0	1,7	16,6
P18Ex11	19,5	22,2	18,6	14,0	2,8	23,8

Lieferbare Typen / Available Versions:

Anzahl der Stifte

*number of pins*

8

12

Bestell-Code

*Ordering-Code*

P11Ex7\_SMD

P18Ex11\_SMD



## SMD ANSCHLUSSPLATTE: SMD HEADER

Material:	Hochtemperaturbeständiger Duroplast (Phenolharzformmasse) verstärkt mit Glasfaser, gelistet nach UL 94 VO.
Stifte:	Lötschwerte aus CuSn, galvanisch beschichtet mit Sn, lötlbar nach DIN IEC 60068-2-20, Prüfung Ta, Methode 1, Alterung 3: 255° C, 2 sek.
Lötung:	nach IEC 60068-2-20, Prüfung Tb, Methode 1B: 350° C bei 3,5 sek bzw. 400° C bei < 2 sek; Abstand zum Lötbad mindestens 0,5 mm.
Mechanische Werte:	Co-planarität: Angabe von Maßen entfällt, da die Lötschwerte frei gelagert

<i>Material:</i>	<i>High temperature resistant thermosetting material (phenolformaldehyde) acc. to UL 94 VO, glassfibre reinforced.</i>
<i>Pins:</i>	<i>Terminals made of CuSn, with galvanic tin plating (Sn), solderable acc. to DIN IEC 60068-2-20, test Ta, method 1, curing 3: 255° C, 2 sec.</i>
<i>Soldering:</i>	<i>to IEC 60068-2-20, test Tb, method 1B: 350° C / 662° F for 3,5 sec. or 400° C / 752° F for &lt; 2 sec., distance to solderbath min. 0,5 mm / 0,02 inch.</i>
<i>Mechanical data:</i>	<i>Co-planarity: no specification required as terminals are free floating.</i>